

RELATÓRIO DE NPI

FR455

REFERÊNCIAS BÁSICAS

DESCRIÇÃO: 27272 CÓD. PRODUTO: 7272

№ OP: 272 CLIENTE: SSAT SINALIZACAO E ADESIVOS EIRELI

QIDE TOTAL OP: 727	Q1DE NPI: 2/2/		DATA: 2022-11-16		
	А	PRESENTAÇÃO DO I	NPI		
Aplicação do Produto:		Classe (IPC-A-610)	Classe (IPC-A-610):		
Documentação está Ok : SIM		Falta o documento	Falta o documento de:		
Item possui revisão anterior: SIM		Qual cód.?			
Origem do Stencil?		Data de chegada: 2022-11-16			
Etiquetas do cliente? SIM		Quant. Etiquetas:	Quant. Etiquetas:		
Tipo de Liga: Lead free		Instr. de Montagem Especial? SIM			
		Etapas produtivas	:		
SMT Bottom	☐ Mont. PTH	☐ Teste	□ OBA		
☐ SMT Top	☐ Mont. Lean	☐ ICT	☐ Certificado de Qualidade		
□ AOI	☑ Verniz	✓ Gravação	Registro de Histórico do Produto		
☐ Outros		☐ Produtos Químicos (NOVO)			
Ações de melhoria:					
☐ desenvolver gabarito	✓ recolher documentação	painelizar PCI	☑ Solicitar teste (doc, jiga licença p/ Sist. Operacional)		
Comentários quanto a apresentação do novo produto:					
REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO					
Organizador (Eng. de Produ	uto): Ana Paula Jahnz		Data: 2022-11-16		
Participantes:					
Eng. de Processo PTH: Ann	a Paulla da Rocha		Eng. de Teste: Cleber Brantl de Souza		
Eng. de Processo SMT: Aro	ilde Istailer Barbosa Souza		Comercial: Ana Carla Mendes		
Eng. da Qualidade: Adriana	F. de Lima Jeremias		Outros:		

REALIZAÇÃO DO NPI

ALMOXARIFADO		
Responsável : Wajdi Ben Helal Data: 2022-11-16		
Atividade: Separação de materiais no almoxarifado		
☐ Foi identificado alguma divergência de materiais?		
☐ Algum componente será montado sob desvio?		
Comentários quanto a apresentação do novo produto:		
MONTAGEM SMT		
Run10 nº.: 2		
EXECUÇÃO DA MONTAGEM SMT		
Responsável : Wajdi Ben Helal Data: 2022-11-16		
Atividade: Printer		
Stencil: identificado algum problema ou oportunidade de melhoria? $\hfill\Box$		
Tipo de insumo aplicado?		
Tipo de apoio utilizado na Printer?		
Inspeção por SPI? □		
Serigrafia: identificado algum problema ou oportunidade de melhoria? \Box		
Atividade: Inserção automática		
Em qual linha foi realizado o NPI?		
Inserção do Bottom: algum problema ou oportunidade de melhoria? □		
Inserção do Top: algum problema ou oportunidade de melhoria? □		
Atividade: Reflow e Inspeção		
Perfil: foi utilizado o perfil "padrão"? □		
Se NÃO, informar nome do perfil utilizado:		
Realizado inspeção visual?		

Atividade: Router					
Utilizado base dedicada ou pinos de apoio durante NPI?		Identificado algum problema ou oportunidade de melhoria?			
VERIFICAÇÃO DA MONTAGEM SMT (RUN10)					
Responsável : Wajdi Ben Helal		Data: 2022-11-16			
VERIFICAÇÃO PARCIAL - MONTAGEM SMT					
Seq. de Placas (número de série)	OK/FALHA	Descrição da Falha			
Placa 1 : xdqzd	Ok	xdqz			
Placa 2 : 6456464	Ok	2574582			
Placa 3 : 121651	Ok	xdqzxdq			
Placa 4 : 615165	Ok	qzdxqzd			
Placa 5 : 65165165	Ok	qzxdqzdx			
Placa 6 : 65465465465	Ok	qzxdzq			
Placa 7 : 65465464	Ok	xzqd			
Placa 8 : 165165	Ok	xdqzd			
Placa 9 : xdzqxdq	Ok	xdqdxzqdx			
Comentários técnicos e Análise crítica referente a Montagem SMT: test					
Houve problemas críticos?					
Gerado documento devido a problemas?					
Verificação da Montagem SMT APROVADO					
Validado por: Nilson Ishikawa		Junto com: Nilson Ishikawa			
MONTAGEM THT/LEAN					
Run10 nº.:					
EXECUÇÃO DA MONTAGEM THT/LEAN					
Responsável: Wajdi Ben Helal		Data: 2022-11-17			
Atividade: Pré forma					

Os componentes possuem especificações quanto à altura, clinche ou ângulo?			
Foi identificada alguma dificuldade de pré formatação?			
Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações? ☐			
Atividade: Cablagem			
Todos os cabos contêm suas especificações? □			
Existem especificações e desenhos de montagem do produto?			
As especificações e desenhos podem gerar dúvidas no operador?			
Existem pontos que podem ser modificados para melhorar o processo?			
Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações?			
Atividade: Pré compor			
Houve alguma dificuldade na depainelização? □			
Existem pontos que podem ser modificados para melhorar o processo?			
Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações? ☐			
Atividade: Compor			
Foi identificado algum problema durante a montagem? □			
Se foi utilizado pallet seletivo, ele atendeu ao processo?			
Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações?			
Atividade: Soldar PTH/Inspeção			
Foi identificado algum problema durante a operação de montagem?			
A atividade de Touch up será necessário? □			
O layout da placa facilita a operação de ressolda? □			

Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações? □				
	Atividade: Montagem Mecânica/Mo	ontagem Final		
Todos os componentes contêm suas espe □	cificações?			
Existem especificações e desenhos de mo	ntagem do produto?			
As especificações e desenhos podem gera	ar dúvidas no operador?			
Existem pontos que podem ser modificado	s para melhorar o processo?			
Existe a aplicação de verniz no produto?				
Necessário desenvolvimento de gabaritos	ou ferramentas para as operações?			
VERIFICAÇÃO DA MONTAGEM THT/Lean (RUN10)				
Responsável: Wajdi Ben Helal		Data:		
VERIFICAÇÃO PARCIAL - MONTAGEM THT/LEAN				
Seq. de Placas (número de série)	OK/FALHA	Descrição da Falha		
Placa 1 : xdqzd	Falha	eezaxd		
Placa 2 : 6456464	Ok	azsw		
Placa 3 : 121651	Falha	а		
Placa 4 : 615165	Ok	szasw		
Placa 5 : 65165165	Ok	az		
Placa 6 : 65465465465	Ok	dxzq		
Placa 7 : 65465464	Ok	fefce		
Placa 8 : 165165	Ok	xqzd		
Placa 9 : xdzqxdq	Ok	xdzqxdqz		
Comentários técnicos e Análise crítica referente a Montagem THT/Lean: csf				
Houve problemas críticos? 1				
Gerado documento devido a problemas?	Doc.:			

APROVADO Verificação da Montagem THT/Lean

Validado por: Nilson Ishikawa Junto com: Nilson Ishikawa **TESTES** Run10 nº .: **EXECUÇÃO DO TESTE** Responsável: Wajdi Ben Helal Data: **EXECUÇÃO DO TESTE** Qual tipo de teste é realizado? Testes/Jiga desenvolvido por? ☐ Cliente acompanhou o processo de implementação dos testes? ☐ Identificado algum problema ou oportunidade de melhoria? ☐ Jiga e/ou dispositivos de Testes podem causar algum "choque mecânico"? ☐ Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações? **RESULTADOS DO TESTE** Responsável: Wajdi Ben Helal Data: 2022-11-17 VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS DO TESTE OK/FALHA Seq. de Placas (número de série) Descrição da Falha Placa 1 : xdqzd Ok dxqzdzq Placa 2: 6456464 Ok xdzqd Placa 3 : 121651 Ok zxqd Placa 4: 615165 Ok dxqzd Placa 5 : 65165165 Ok dqxzd Placa 6: 65465465465 Ok qzxdq Placa 7: 65465464 Ok zdxqzd Placa 8 : 165165 Ok xqzdxzq Placa 9: xdzqxdq Ok xdzqxdzq Comentários técnicos e Análise crítica referente ao Testes: dxzqd

EMBALAGEM					
Run10 nº.:					
Responsável : Wajdi Ben Helal			Data: 2022-11-17		
Atividade: Embalagem					
☐ Embalagem é pertencente ao Cliente?	☐ Há necessidade d ESD?	e etiqueta	✓ Comentários técnicos referente a etapa de Embalagem:		
Qual tipo de embalagem será utilizado?					
Como a embalagem será fechada?					
REUNIÃO DE FECHAMENTO (report de mudanças e validação final)					
Organizador (Eng. da Qualidade) : Ana Paula Jahnz			Data: 2022-11-17		
	Pa	articipantes:			
Eng. de Processo PTH: Anna Paulla da Rocha			Eng. de Teste: Adriana F. de Lima Jeremias		
Eng. de Processo SMT: Aroilde Istailer Barbosa Souza			PCPM: Adriana F. de Lima Jeremias		
Eng. de Produto: Adriana F. de Lima Jeremias			Outros:		
ANÁLISE CRÍTICA: xdqzdzq					
Responsável Eng. de Processo: (autorização de mudanças) Wajdi Ben Helal					
PARECER FINAL STATUS					
APROVADO					
Com restrições? SIM		Implementaç	ão de: dxzq		
Novo Run10 é possível? *outra tentativa imediata para nova análise crítica SIM		Responsáve mudanças) V	Responsável Eng. da Qualidade: (parecer final) (autorização de mudanças) Wajdi Ben Helal		